

信頼性

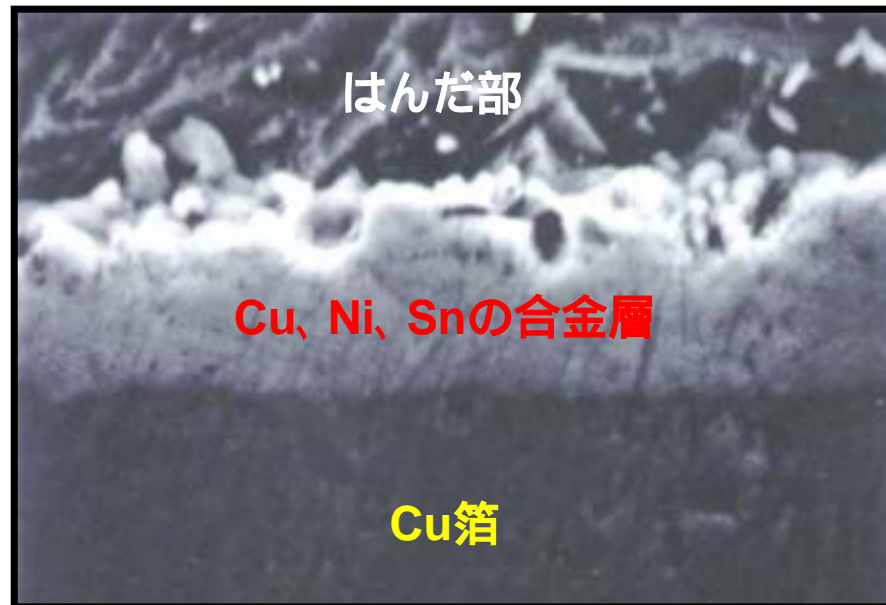
安定した合金層



SN100Cは、高い信頼性を持つ鉛フリーはんだです。
SN100Cの「安定した合金層」の形成についてご説明いたします。

安定した合金層

SN100Cは銅箔とはんだとの界面に安定した合金層を形成します。

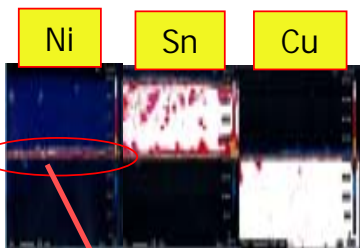


SN100Cは銅箔とはんだとの界面に、Cu、Ni、Snの安定した合金層を形成します。

高温放置試験

【条件】

- ・高温放置： 120
- ・はんだ付： 255



Niバリア層

$(\text{Cu}, \text{Ni})_6\text{Sn}_5$

Cu_6Sn_5

はんだ 合金 時間(h)	断面拡大写真		
	SN100C	Sn-0.7Cu	Sn-3.0Ag-0.5Cu
0			
192			
768			



120 の高温放置試験を行いました。
Sn-0.7CuやSn-3.0Ag-0.5Cuは時間と共に合金層が成長していますが、
SN100Cは、ニッケルのバリア効果によって合金層の成長が抑制されています。